

No.	项目	内容描述	工艺能力
1	可生产层数	层	基板, 1层 (单面) , 2层 (双面)
2	材料	-	氧化铝,氮化铝,氧化锆,氧化铅,氧化硅, 蓝宝石,金刚石,氮化硅
3	表面处理工艺	-	沉金, OSP, 沉银, 镀金, 沉镍钯金
4	阻焊颜色	-	绿色, 黑色, 哑光黑色, 蓝色, 红色, 白色, 哑光绿色
5	字符颜色	-	白色, 黑色
6	可制造板厚范围	mm	0.1-4mm
7	最大板尺寸	mm	标准: 101x101mm,定制: 205x205mm
8	最小板尺寸	mm	1x1mm
9	外型公差	mm	±0.1mm(标准),±0.03mm(极限)
10	成型方式	-	激光,水刀
11	V-CUT	-	激光预切
12	最小焊盘	mm	0.15mm
13	最小线宽	mm	0.03mm

14	最小线距	mm	0.03mm
15	层间对对位偏差	mm	0.03mm
16	最小钻孔	mm	0.06mm
17	出货方式	-	单片, 连片
18	支持塞孔方式	-	电镀填孔,阻焊塞孔
19	板厚公差	mm	标准: 板厚±10%, 极限: ±0.05mm
20	基材厚度公差	mm	±0.03mm
21	可开孔, 槽的形状	-	圆型, 方型, 异形, 半孔
22	板边金属化 (板边包金)	-	可以
23	导热系数范围	W/MK	20-280W/MK
24	铜厚范围	um	5-175um
25	围坝高度范围	-	100-1000um
26	孔径公差	-	±0.05mm
27	覆铜工艺	-	DPC + 电镀